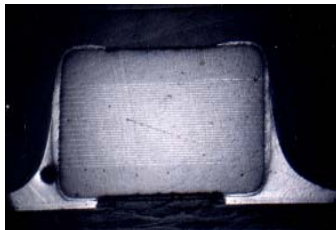
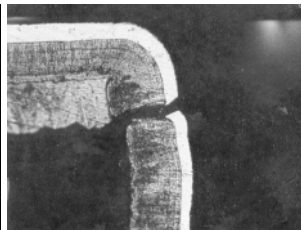


COUPE MICROGRAPHIQUE Sur une carte électronique (examen destructif)

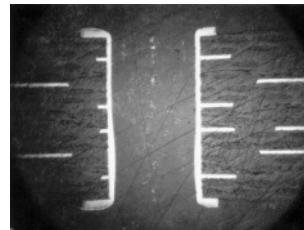
INFORMATIONS SUR CE SERVICE



Bulle dans le joint du chip



Rupture de métallisation



Décentrage des couches



Smearing

Travaux réalisés :

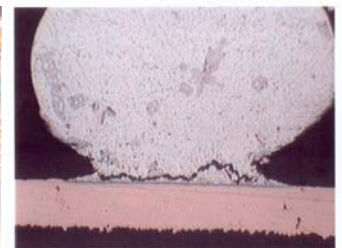
- Prélèvement d'un échantillon du circuit comportant la zone à examiner (trou ou joint brasé)
Note : nous ne pouvons pas sectionner les composants en céramiques
- Enrobage de l'échantillon dans la résine, puis 24 heures de polymérisation à froid.
- Démoulage, ponçage puis polissage à la pâte diamantée et à OPS.
- Examen au microscope optique : résolution jusqu'au micron.
 - * recherche des défauts de structure sur circuit imprimé ou sur joint brasé.
(fissures, nodules, smearing, cavités, ...)
 - * mesures dimensionnelles selon la demande.
(largeur, épaisseur, isolements, intermétalliques ...)
 - * réalisation de photos sur les défauts typiques observés.

- Rédaction d'un rapport d'examen comportant les photos éventuelles. (au moins une photo typique en l'absence de défaut)

Délai : généralement dans la semaine, sauf quantité importante ou difficultés particulières (nous consulter).



Coupe sur une ligne de billes de BGA



Fissure sur BGA

Coût : selon la quantité ; merci de nous consulter.